東京大学微細加エプラットフォーム 超微細リソグラフィー・ナノ計測拠点 『マルチフィジックスシミュレーションセミナー I』

半導体デバイスシミュレーションができるまで

2017年7月26日(水) 東京大学 VDEC **池野理門**



内容

- □ 半導体デバイスシミュレーションの基礎
 - □ シミュレーションの目的
 - □ 半導体デバイスの支配方程式
 - □物理モデル(キャリア移動度、生成消滅項)
- □ 半導体デバイスシミュレーションの数値解析手法
 - □ 様々な離散化の手法
 - □ 有限体積法による支配方程式の離散化
 - □ 線形化(ニュートン法)と連立方程式の行列解法
 - □ 大規模疎行列の高速解法
- □ 半導体デバイスシミュレーションの展望
 - □ 半導体技術を取り巻く環境の変化
 - □ 半導体デバイスシミュレーションの進化



半導体デバイスシミュレーションの基礎



シミュレーションとは

□ モデリングと数値解析に基づく物理現象の予測・分析 □ 現象の原理の理解と実例への数値解析手法の適用

□ 対象

- □ 固体力学:構造、応力、変形
- □流体力学:流動、圧力、粘性、圧縮・非圧縮
- □熱:伝熱
- □光学:波動、光線
- □ 電気、電磁気

□ 支配方程式

- □ ラプラス方程式(ポアソン方程式)
- □ 波動方程式
- □ マックスウェル方程式





半導体デバイスシミュレーションの目的

□ 行うこととその効果

- □ 半導体内部の電気伝導現象に関する支配方程式を数値計 算手法によって解く
- □ 半導体内部の電位分布、キャリア分布を再現し、デバイスの電気的特性を製造前に理解する
- □ デバイス製造を行わずにデバイスの特性を予測する
- □ デバイス構造や製造プロセスの設計、改善を効率化する



半導体デバイスシミュレーションのための物理

- □ 半導体の状態を記述する物理量
 - □ ポテンシャル(電位)分布 ψ
 キャリア分布(電子密度 n、正孔密度 p)
 ▲ (これらを求める)
 □ 固定電荷(不純物)分布(ドナー濃度N_D、アクセプタ濃度N_A)
 □ キャリアの移動や生成・消滅の様子(電流)



半導体デバイスシミュレーションの支配方程式

$$\frac{\partial p}{\partial t} - \nabla \cdot (\mu_p \cdot p \cdot \nabla \psi + D_p \cdot \nabla p) = GR$$
 [正孔電流連続式]



半導体デバイスシミュレーションと物理モデル(1)

□ キャリア移動度 μ_n, μ_n

- □ 電界に対するキャリアの移動のし易さを表すパラメータ
- □ 移動度はキャリアに対する種々の「散乱」要因から決まる
- □ ある「散乱」 *S* が緩和時間 τ_S で起こる時、その散乱によって 決まる移動度は $\mu = q\tau_S/m$ (*m* はキャリアの有効質量)



□ 移動度と拡散係数の間には「アインシュタインの関係式」が 成り立っている。(熱平衡状態から導出)

$$u_n = \frac{q}{kT} D_n$$

8

東京大学

半導体中の散乱要因と移動度モデル

□ フォノン散乱

□ 熱振動による結晶格子の周期性の乱れ

□ 不純物散乱(イオン化、中性)

□ 固定電荷との電気的干渉、結晶格子点外の原子との干渉

□ 表面散乱

□ MOS界面などでの縦電界による界面との衝突

□ キャリア間散乱

□ キャリア密度が高い場所での互いの干渉

□ 速度飽和

□ 高電界中でキャリア速度が電界に比例しなくなる際の補正 □ 複数の散乱要因が存在する場合の移動度

□ 原理的には「マーティセンの法則」(Matthiessen's rule)に 従うが、実用的には様々な複合モデルが提案されている

 $1/\mu_{\text{Total}} = 1/\mu_{\text{A}} + 1/\mu_{\text{B}} + 1/\mu_{\text{C}} + \cdots$





半導体デバイスシミュレーションと物理モデル(2)

□ キャリアの生成消滅項

□ Auger 再結合

- □ 熱や光によるキャリアの発生と再結合による消滅の差
- □ 基本的には熱平衡状態からのズレを戻す方向に働く
- □ Shockley-Read-Hall(SRH)再結合
 - □ バンドギャップ中のトラップ準位を介した間接遷移

$$R^{SRH} = \frac{np - n_i^2}{\tau_p(n + n_i) + \tau_n(p + n_i)}$$

□ 直接遷移による再結合

$$R^{AU} = (np - n_i^2)(C_n \cdot n + C_p \cdot p)$$

□ インパクト・イオン化(Impact Ionization)
 □ 高エネルギーのキャリアの衝突による電子正孔対の励起

$$G^{II} = \frac{1}{q} \left(\alpha_n \cdot |\mathbf{J}_n| + \alpha_p \cdot |\mathbf{J}_p| \right)$$

→ モデル式中に電流値を含むので、定式化が複雑になる





半導体デバイスシミュレーションの 数値解析手法



シミュレーション(数値解析)実現までの流れ



東京大学

THE UNIVERSITY OF TOKYO

さまざまな離散化手法(1)

□ 有限差分法(Finite Differential Method; FDM) による離散化



・ <u>各格子点に関する連立(一次)方程式</u>を作る

・基本的には構造格子を対象にするので、複雑な形状の精度に課題





さまざまな離散化手法(2)

□ 有限要素法(Finite Element Method; FEM)による離散化



- ・要素内部の状態を接点の未知数値を変数とする補間関数で表す
- ・各要素に対する方程式の係数を組み合わせて全体の方程式を作る
- ・要素形状が任意なので、複雑な形状にも対応できる



さまざまな離散化手法(3)

□ 有限体積法(Finite Volume Method; FVM)による離散化



- ・支配方程式をコントロールボリューム内で積分し、それを離散化する
- ・有限要素法と比較して簡便な定式化ができる
- ・コントロールボリュームの流れの出入りを定式化する
- ・要素形状が任意なので、複雑な形状にも対応できる



離散化手法の比較



16

THE UNIVERSITY OF TOKYO

有限体積法による定式化:微分形→積分形(1)

□ ガウスの(発散)定理に基づく支配方程式の書き換え



有限体積法による定式化:微分形→積分形(2)
□ ガウスの(発散)定理に基づく基本方程式の書き換え(つづき)

<u>電子電流連続式の書き換え</u>

体積積分
(
$$\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla \cdot (\mu_n \cdot n \cdot \nabla \psi - D_n \cdot \nabla n) = q \cdot GR$$

2階微分
($\int_V \frac{\partial n}{\partial t} dv + \int_V \nabla \cdot (\mu_n \cdot n \cdot \nabla \psi - D_n \cdot \nabla n) dv = \int_V GR dv$
発散定理
($\int_V \frac{\partial n}{\partial t} dv + \int_S (\mu_n \cdot n \cdot \nabla \psi - D_n \cdot \nabla n) \cdot \mathbf{v} ds = \int_V GR dv$
+積分

正孔電流連続式の書き換え(結果のみ)

$$\int_{V} \frac{\partial p}{\partial t} dv - \int_{S} (\mu_{p} \cdot p \cdot \nabla \psi + D_{p} \cdot \nabla p) \cdot \mathbf{v} \, ds = \int_{V} \mathrm{GR} \, dv \quad \frac{1 \mathrm{BR} \partial p}{+ \mathrm{ER} \partial t}$$





有限体積法による定式化:離散化(1)

□ ポアソン方程式 (2次元構造格子、均等メッシュの例)
 積分形



 $E_{x}(\psi_{e} + \psi_{w}) + E_{y}(\psi_{n} + \psi_{s}) - 2(E_{x} + E_{y})\psi_{o} + qV(p_{o} - n_{o} + N_{D} - N_{A}) = 0$

東京大学

有限体積法による定式化:離散化(2)

□ 電子電流連続式

<u>積分形</u> $\int \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t} dv + \int_{\mathcal{O}} (\mu_n \cdot \mathbf{n} \cdot \nabla \psi - D_n \cdot \nabla \mathbf{n}) \cdot \mathbf{v} \, ds = \int_{\mathcal{U}} \operatorname{GR} dv$ とりあえず時間変化は考えない(定常解) $\frac{1}{2} \frac{n_e + n_o}{2} \cdot \frac{\psi_e - \psi_o}{\Lambda x} \Delta y + \mu_n \frac{n_w + n_o}{2} \cdot \frac{\psi_w - \psi_o}{\Delta x} \Delta y$ $+\mu_n \frac{n_n + n_o}{2} \cdot \frac{\psi_n - \psi_o}{\Delta y} \Delta x + \mu_n \frac{n_s + n_o}{2} \cdot \frac{\psi_s - \psi_o}{\Delta y} \Delta x \right)$ $-\left(D_n\frac{n_e-n_o}{\Delta x}\Delta y+D_n\frac{n_w-n_o}{\Delta x}\Delta y+D_n\frac{n_n-n_o}{\Delta y}\Delta x+D_n\frac{n_s-n_o}{\Delta y}\Delta x\right)$ = GR $\cdot \Delta x \cdot \Delta y$ 整理後

 $\{ M_x^n (n_e + n_o) (\psi_e - \psi_o) + M_x^n (n_w + n_o) (\psi_w - \psi_o) \\ + M_y^n (n_n + n_o) (\psi_n - \psi_o) + M_y^n (n_s + n_o) (\psi_s - \psi_o) \} \\ - \{ D_x^n (n_e + n_o) + D_x^n (n_w + n_o) + D_y^n (n_n + n_o) + D_y^n (n_s + n_o) \} - V \cdot GR = 0$





ここまでの定式化結果のおさらい(その1)

- □ 離散化まで済んだ現在の問題:
 - □ 未知数 3N、式数 3N の連立方程式(N:格子点数)
 - □各式は一般に非線形(2次以上の項、指数、分数を含む)
 - □ 各式は中心および近隣の格子点上の未知数(<u>ψ, n, p</u>)の関数





Sharfetter-Gummel 法

- □ キャリア密度は<u>指数的に変化</u>するため、線形の補完(差分) による平均や勾配は精度が悪くなる可能性がある
- □ 電流連続式の離散化に<u>指数関数を導入</u>して改善を図る



【参考】 Sharfetter-Gummel 法の導出

$$\frac{n(x) = C(x) \cdot e^{vx}}{c_0 = v \cdot n - \frac{dn}{dx}}$$
と仮定する(指数項と変動分に分ける)
これを $C_0 = v \cdot n - \frac{dn}{dx}$ に代入すると
 $C_0 = v \cdot C(x)e^{vx} - \left\{\frac{d}{dx}C(x) \cdot e^{vx} + C(x) \cdot v \cdot e^{vx}\right\}$ から
 $-\frac{d}{dx}C(x) = C_0 \cdot e^{-vx}$ が得られる

これを解いて
$$C(x) = \frac{C_0}{v} \cdot e^{-vx} + C_1$$
 すなわち $n(x) = \frac{C_0}{v} + C_1 \cdot e^{vx}$

境界条件
$$\begin{cases} n_o = \frac{C_0}{v} + C_1 \\ n_e = \frac{C_0}{v} + C_1 \cdot e^{v \cdot \Delta x} \end{cases} \quad \text{から、定数は} \begin{cases} C_1 = \frac{n_e - n_o}{e^{v \cdot \Delta x} - 1} \\ C_0 = v \cdot \frac{n_o \cdot e^{v \cdot \Delta x} - n_e}{e^{v \cdot \Delta x} - 1} \end{cases}$$

以上より
$$n(x) = n_o + \frac{e^{vx} - 1}{e^{v \cdot \Delta x} - 1}(n_e - n_o)$$



過渡解析のための時間離散化の方法

□ 時間変化の解析の方法は以下の二通りが考えられる

$$\int_{V} \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t} dv + \int_{S} (\mu_{n} \cdot \mathbf{n} \cdot \nabla \psi - D_{n} \cdot \nabla \mathbf{n}) \cdot \mathbf{v} \, ds = \int_{V} \operatorname{GR} dv$$

① <u>**陽解法:**</u> n_o は1つ前の時刻の値(n'_oなど)から直接求める





② 陰解法: 全ての値を各時刻でその都度求め直す





ここまでの定式化結果のおさらい(その1)[再掲]

- □ <u>離散化まで済んだ現在の問題</u>:
 - □ 未知数 3N、式数 3N の連立方程式(N:格子点数)
 - □各式は一般に非線形(2次以上の項、指数、分数を含む)
 - □ 各式は中心および近隣の格子点上の未知数(<u>ψ, n, p</u>)の関数



非線形連立方程式の求解

□ 非線形方程式の Newton 法による解法(1元の場合)



以下の F(x) に1次のTailor展開を施した下記の方程式を解く。

$$F(x^*) + \frac{dF}{dx}(x^*) \cdot \frac{\delta x}{\delta x} = 0$$

- 求めた δx を用いて x^* を更新する。 $(x^* + \delta x \rightarrow x^*)$
- これを δx が十分小さくなるまで繰り返し、得られた x^* を解 x とする。





連立方程式の線形化

□ 多元方程式の線形化

□ 多変数方程式のTailor展開は一般に以下のようになる

$$F(\mathbf{x}^*) + \frac{\partial F}{\partial x_1}(x^*) \cdot \frac{\delta x_1}{\delta x_2} + \frac{\partial F}{\partial x_2}(x^*) \cdot \frac{\delta x_2}{\delta x_3} + \frac{\partial F}{\partial x_3}(x^*) \cdot \frac{\delta x_3}{\delta x_3} + \dots = 0$$

□ 複数の式を連立する

□ 以下のような行列形式に書ける
 □ 式の数と未知数の数がともに 3N なので、正方行列になる



東京大学



連立方程式の求解(行列解法)

□ 大規模な連立一次方程式を解く場合の問題
 □ 直接法(真面目な求解)はメモリ使用量や計算時間が膨大
 □ メモリ使用量: 0(N²)、計算量:0(N³)

<u>直接法の例: Gauss消去法</u>



東京大学

LU分解と直接解法

□ 行列 A を A = L·U の形の積に分解しておく
 □ L: 下三角行列、U: 上三角行列

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{2,1} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ l_{n,1} & l_{n,2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & \cdots & u_{1,n} \\ 0 & u_{2,2} & \cdots & u_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{n,n} \end{pmatrix}$$
$$A = L \cdot U \text{ OTM} [\Box \text{ OTM}]]] \\ A \cdot x = b \\ L \cdot \underline{Ux} = b \\ y \checkmark$$
$$L \cdot y = b \Rightarrow y = L^{-1} \cdot b \quad (1) \text{ fi} \# (\Lambda \text{ cfl} \# \text{ off} \\ U \cdot x = y \Rightarrow x = U^{-1} \cdot y \quad (2) \text{ & } \text{$$

□ LU分解自体の計算量を考えると<u>トータルの計算量は不変</u>
 □ 一つの<u>A</u>を複数のbに対して解く場合は<u>分解が一度で済む</u>





反復解法による行列計算(1)

- 直接解法はメモリ使用量や計算量が多い
 大規模行列では反復解法による収束計算が一般的
 反復解法の種類
 - □ 定常法: 同じ行列、ベクトルを使用した漸化式・遅い □ 非定常法:残差ベクトルの基底の直交性を利用・速い
- □ 定常法の例(Jacobi法)
 □ A·x = b の代わりに $x^{(k+1)} = M \cdot x^{(k)} + c$ を繰り返し解く
 □ どんな M と c を使えば良い? $x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{i,i}} \left(b_i \frac{a_{i,1}x_1^{(k)} \dots a_{i,n}x_n^{(k)}}{i \text{ 以外}} \right)$ □ その心は・・・ $a_{i,1}x_1^{(k)} + \dots + a_{i,i}x_i^{(k+1)} + \dots + a_{i,n}x_n^{(k)} = b_i$

を $x_i^{(k+1)}$ について(それ以外は既知として)解いている



反復解法による行列計算(2)

*より*積極的に真の解を目指すような解の修正を考える

 下記漸化式で修正方向ベクトル *p_i*と係数 *α_i*を求める

$$\underline{x^{(i+1)} = x^{(i)} + \alpha_i \cdot \underline{p}_i} \rightarrow x = x_0 + \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \cdot \underline{p}_i$$



p_i, *a_i* の求め方については、様々な方法が提案されている
 □ 共役勾配法/CG法(Conjugate Gradient Method)
 □ BCG法(Bi-Conjugate Gradient Method) ← 非対称行列
 □ BiCGSTAB法(Bi-Conjugate Gradient STABilized)





行列計算のテクニック

- □ デバイスシミュレーションで扱うJacobi行列をよく見てみると
 - □ 1本の式に現れる未知数の数は 3N よりも<u>ずっと少ない</u>
 → 行列中の<u>殆どの要素は 0</u>(=疎行列)
 - □ 非ゼロの行列要素は<u>対角に対して対称</u>に現れる
 - □ 構造格子(直交格子)の場合は対角要素に並行した非ゼロ 要素列が現れる<u>バンド行列</u>になる



大規模疎行列の行列解法

- □ 大規模疎行列(large sparse matrix)ならではの解法がある
 □ 行列の(メモリへの)格納 → 非ゼロ要素は無視
 - □ (不完全)LU分解を利用した反復解法
 - □ 行列の分割と並列化(行列の入れ替え)



不完全LU分解による前処理と反復解法

□ 大規模疎行列は「手を抜いて」解くことができる
 □ 反復解法で収束させれば良い → 厳密な逆行列は要らない
 → LU 分解でフィルインを手抜く=<u>不完全LU分解</u>





大規模行列解法の高速化・並列化

□ 最大の課題である不完全ILU分解の並列処理による高速化 □ 対象の行列をいくつかのブロックに分割して並列処理する

4x4 のブロックを4台のPEに分散

領域分割と行(接点)の順序入れ替え



- ・処理を開始するまでの 待機時間が生じる
- ・PE間の通信量が多い



- ・デバイスの構造(形状)を反映した分割
- ・領域間の境界面も独立した領域とする
- ·並列度向上&通信量削減





半導体デバイスシミュレーションの数値解析のまとめ



THE UNIVERSITY OF TOKYO

半導体デバイスシミュレーションの展望



半導体デバイスシミュレーションの現状と展望

半導体技術をとりまく環境の変化
 微細化の減速・限界と多様なブレークスルーの方向性
 構造:FinFET、3D集積、微細形状
 材料:SiC、SiGe、III-V、HBT、high/low-k

アプリケーション領域の拡大
 Flash メモリ、相変化・抵抗メモリ
 パワーデバイス
 イメージセンサ、太陽電池

新たな課題 高信頼性(経年劣化、ソフトエラー) 生産性(バラつき、歩留まり、コスト)





半導体デバイスシミュレーションの現状と展望

- □ 半導体デバイスシミュレーションの進化
 - □新たな物理現象とモデルへの対応(マルチフィジックス)
 □熱、ストレス、光子吸収・放射、電磁界
 □高エネルギーキャリア輸送、キャリア量子化、トラップ
 □化合物材料、ヘテロ接合、結晶方位
 - □ 複雑な解析対象への対応
 □ 静電破壊、電荷漏洩
 □ソフトエラー、ラッチアップ、熱暴走
 - 多様な構造への対応
 大規模3次元解析、回路-デバイス連成解析
 メッシュ生成、高速ソルバー、並列化





ありがとうございました

